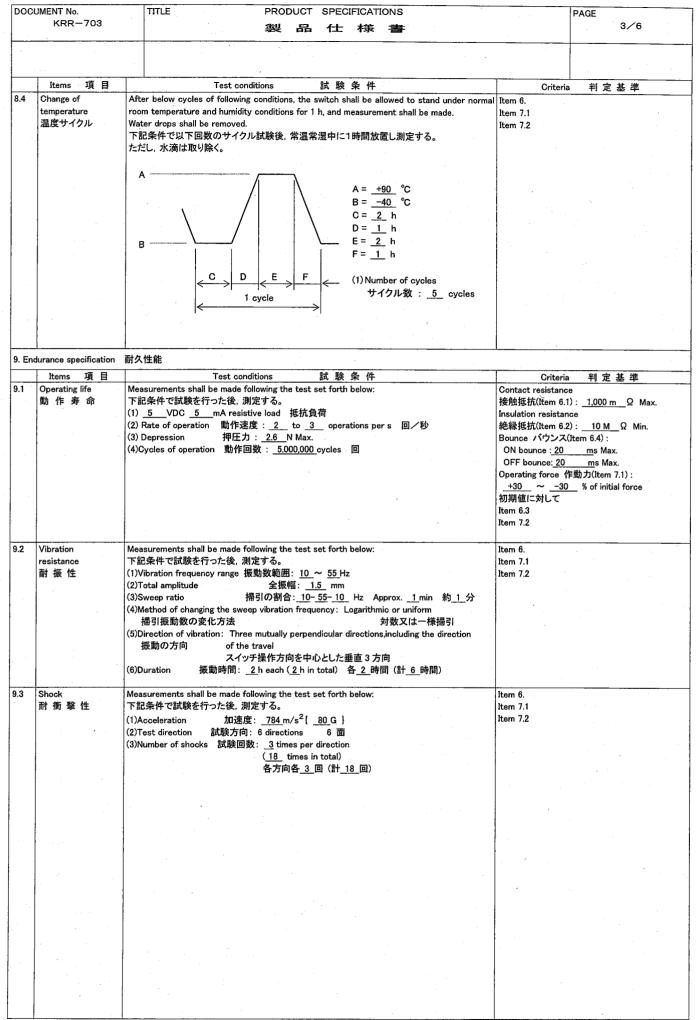
DOC	UMENT No.	TITLE	PRO	DUCT	SPECI	FICATION	S		PAGE
	KRR-703		製	品	仕	様 書	ŧ		1/6
BACI	KGROUND	·							
٠.								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	neral 一般事項				,				L
1.1	Application 適用氧		is applied to TACT				p		
1.2	Operating temperature ra		, キートップなしのタ外ス・ _ <u>-40_</u> ~ <u>85</u> _℃				r pressure 常温·	堂圧)	
1.3	Storage temperature ran	ge 保存温度範囲:	_40 ~ 90 °	C (norr	nal humid	dity,normal a	ir pressure 常湿	·常圧)	
1.4	Test conditions 試験状		specified, the atmosp					tests are as follows	.
		試験及ひ測定 Normal tem	は特に規定がない限 perature 常			態のもとで行 re 温度 5~			
		Normal hum			-	ity 湿度 25			*
	Ÿ.	Normal air p	pressure 常	王:(Air p	ressure	気圧 86~	106kPa)		
			rise from judgement,				he following conditi	ons.	
		バニバン、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ニ疑義を生じた場合は mperature 温	、以下のき 度: 20±		で行う。			•
		Relative hu							
		Air pressure	9 気 「	Ξ: 86~	106kPa				
2. An	nearance, style and dime	nsions 外観, 形状, 寸ž	±						
	Appearance 外観		shall be no defects t	hat affec	t the se	rviceability of	of the product.		•
		性能	上有害な欠陥があっ	てはなら	ない。				
2.2 3	Style and dimensions 开	ジ状、寸法 Refer to t	he assembly drawing	s. 製品	図による	o ·			
3. Tyi	pe of actuating 動作形	式 Tactile feedb	ack タクティール	フィードバ	ック				
					_				
4. Co	ntact arrangement 回路			各 <u>1</u> 接			mana -		· ·
5. Rat	tings 定格	(Details of	contact arrangement	are give	n in the	assembly dr	awings 回路の	詳細は製品図によ	6)
	Maximum ratings 最大深	È格 <u>12</u> V DC	<u>50 m</u> A						
۸									·
b. Lie		気的性能		-4 #4	Az 1st	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	stor — state state
6.1	Items 項目 Contact resistance	Applying a below static lo	t conditions ad to the center of t		条件 measure		he	Criteria 500 m Ω Max.	判定基準
	1	made.		10 000111,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	mortes strain	,	- OOO III JE IVIAX.	
		スイッチ操作部中央に下記の		きする。					
		(1) Depression	押圧力: <u>4</u> N 删字方法:1,Ы3 ama	II_ a.					ut u
		(2) Measuring method 測	明足刀法:I KHZ SMa drop meth				meter or voltage		,
			·				0mA 電圧降下法		
6.2	Insulation I	Vieasurements shall be m	ade following the test	t set fort	h below:			100 M Ω Min.	
	resistance	下記条件で試験を行った							. "
	絶縁抵抗		ロ電圧: <u>100</u> VDC						
	.	(2) Applied position 印力	山場門: Between all te between termi				tal frame,		
			端子間,金属フ				金属フレーム間	-	* .
6.3	Voltage proof	Measurements shall be m	ade following the test	set fort	h below:			There shall be no	breakdown.
	耐電圧	下記条件で試験を行った		. /ro. o			1.	絶縁破壊のないこ	と。
			加電圧: <u>_100</u> _V AC 印加時間:1 min	; (5U~6(JHz)				*
/			加場所:Between all t	erminals	And if t	here is a me	tal frame,		
	, ,		between tern		_				
		*	骗 <u>子間,金属</u> 、	フレーム	がある場	合は, 端子	と金属フレーム間	* *	
		-					*		
								-	
							•		
		y €					* 5		
						•.			
			*						
			•				-		
							<u> </u>	DSGD. CV1.	76-700>
		<u> </u>						i	
									M-SUZUKI
		·						CHKD. Oct.	26.2007
							1	I	Vankewa_
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						APPD. Oc.E.	The 2009
		<u></u>							
PAGE	SYMB BA	CKGROUND	DATE	APPD		CHKD	DSGD	1 1.3	ajckeve

וטטטו	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
	KRR-703	製品仕様書		2/6	
				<u> </u>	
				· .	
 	Items 項目	Test conditions 試験条件	0.11	viui ← ++ :#=	
-	<u> </u>		Criteria		
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations			
	バウンス	per s.),bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	OFF bounce: 10	_ms Max.	
		スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時			
		のパウンスを測定する。			
	·				
	1				
	1	Switch			
-		Uscilloscope Oscilloscope		And the second	
		<u>ー</u> 5V 5kΩ オシロスコープ			
		T /			
			:		
			1		
	,	"OFF"			
	<u> </u>	UNIDER OF OF	l <u> </u>		
7. Me	chanical specification	機械的性能			
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
7.1	Operating force	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually	<u>2</u> ± 0.6 N		
	作動力	increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the			
		switch to come to a stop shall be measured.			
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、			
		操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。			
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical andthen applying	0.25 +0.15/-0.1	mm	
	移動量	static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		"ON" shall be measured.			
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、スイ			
		ッチがONするまでの距離を測定する。			
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon	0.3 N Min.		
١,.٠	復帰力	depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot			
İ	12 Mi 73	its free position shall be measured.			
}	,	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操		4	
	`.	作部が復帰する力を測定する。			
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below	Thore shall be no	nime of dominion was best	11
′.7	ストッパー強度	static load shall be applied in the direction of stem operation.		sign of damage mechanic	bany
	ストッハー」強反	la companya da Marana da Arana da Carana	and electrically. 機械的 電気的に	男骨のかいこし	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重な加える。	1成1成ロリ、毛 ヌしロソー	共吊りないこと。	
		を加える。 (() Democries			
		(1) Depression 押圧力: <u>30 N</u>			
		(2) Time 時間: <u>60 s</u> ec			
	·				
8 Env	ironmental specification	n 耐候性能	. 4		
O. LIIV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.		
	temperatures	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1		
	耐寒性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2		
		(1) Temperature 温 度: <u>-40</u> ± <u>2</u> ℃			
		(2) Time 時間: <u>96 h</u>			
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。			
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.		
	耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1		
		次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2		
		(1) Temperature 温度: <u>90</u> ±2°C			
		(2) Time 時間: <u>96</u> h		*	
0.0	Maintur	Fall and on the test and fouth helengths assessed about the 1960 to 1960.	Combact		
8.3		Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Contact resistance		
		temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	接触抵抗(Item 6.1)		
	耐湿性	次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Insulation resistant		
		(1) Temperature 温度: <u>60</u> ± <u>2</u> °C	絶縁抵抗(Item 6.2)): <u>10 M</u> Ω Min.	
		(2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6.3		
		(3) Relative humidity 相対湿度: <u>90 ~ 95</u> %	Item 6.4		
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1		
			Item 7.2		
	*.				
	,				
			. ,		
		· ·			



DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE KPR-703 製品 仕 様 書 4/6 10. Soldering conditions 半田付条件 Items 項 E 推奨条件 Recommended conditions Hand soldering 10.1 Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 半田温度: <u>350</u>℃ Max. (1)Soldering temperature (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと 10.2 Reflow soldering リフロー半田 Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(°C) 260 °C Max. 3 s Max. Peak Temperature ピーク温度 230 180 150 Time 時間 40 s Max. 120s_Max (Pre-heating 予熱) 3 ~ 4 min. Max. Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (2)Allowable soldering time 半田回数: _2_ time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。) 10.3 (1) Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. Other precautions 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 For soldering 半田付けに関する (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. その他注意事項 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により スイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを 設けないで下さい。 (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8)The thickness of cream solder : 0.15 to 0.2 mm クリーム半田印刷厚: 0.15 ~ 0.2 mm

DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
KRR-703		製品 仕様書	5/6	
			1	

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufactured or general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, Informationdevices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

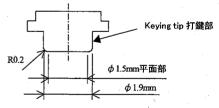
A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

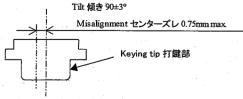
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.
 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので、十分にご注意下さい。
- B5. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings.
 プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Designing printed patten and parts layout shall be condidered becance the characteristics may change due to warp of P.C.B. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- D4. Dimensions of the tip of striking part. 打鍵部先端形状 The demension shall be in accordance with the right Fig. It is recommended that tip of the keying section is flat. 右図に示す形状として下さい。
- D5. The inclination of the striking part shall be within 3°. 打鍵部の傾斜は、3度以内に設定して下さい。



- D6.Operating Conditions. 操作条件
 - Deviation of striking part from the center axis of the switch shall be within 0.75mm. スイッチ外形を基準とする中心軸線よりの、打鍵部ズレは 0.75mm 以下にてご使用下さい。



- D7. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.
 Please avoid using this switch as mechanical detecting function.
 In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.
 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。
 メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。
 検出機能には繁社検出スイッチをご使用下さい。
- D8. Do not place something pointy on the scaling film of the switch. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE	
	KRR-703	製品仕様書		6/6
ŀ				

D9. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

- D10. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- E. Using environment 使用環境
- E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.

同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。

• For parts,rubber materials,adhesive agents,plywood,packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- · When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- *When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand.

製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では,端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.
 製品は納入形態のまま常温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F4. Keyswitches shall be kept as released position,when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the switch alone should fail.

 And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network.

 スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モートとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

